



INTERFLUX®
ELECTRONICS

DP 5600

SnBiAg Lotpaste



Interflux® DP 5600 ist eine no-clean Lotpaste für SnBi(Ag)-Legierungen mit niedrigem Schmelzpunkt.



Lotpaste mit niedrigem Schmelzpunkt



Geringe Voidbildung



Absolut halogenfrei



Hohe Stabilität auf der Schablone

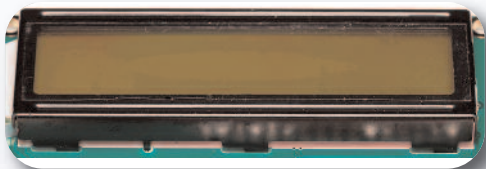


Geeignet fürs Dosieren



Die Akzeptanz von der SnBiAg-Legierung hat sich stark entwickelt in der Elektronifertigungsindustrie. Wenn am Anfang die Legierung hauptsächlich für das Lötten von Verbrauchselektronik und mechanische

Teile wie Abschirmungen angewendet worden ist, hat sie ihren weg gefunden in Bereiche wie Automatisierung, Medizintechnik, Leistungselektronik,...

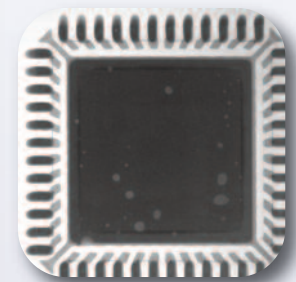


Trotz ihren Einschränkungen, scheint die Legierung ausreichende mechanische Stärke zu haben für viele Anwendungen.

Der Vorteil niedrigerer Prozesstemperatur zeigt sich nicht nur in den Energiekosten aber auch in der drastischer Reduzierung der thermischen Belastung der elektronischen Baugruppe.

Die DP 5600 Lötchemie überwindet die Herausforderungen die die SnBiAg-Legierung bringt im Bereich von Lötbarkeit und Stabilität.

Die Lotpaste weist ein sauberes Lötresultat auf ohne den typischen schwarzen Partikeln. Weiterhin kombiniert Sie geringe Voidbildung mit hoher Stabilität auf der Schablone.



Sn42Bi57Ag1 : ~139°C



Typ 3 und Typ 4



Dosen, Kartuschen und Spritzen



www.interflux.com/de